

概要

この通知は、プラスチックボールグリッドアレイの FG(G) および BG(G) パッケージにおいてピンゲートモールド (PGM) へ移行することをお知らせするものです。ザイリックスのアセンブリサプライヤーは、2014 年 1 月末までにこの移行を進めていきます。この通知は、すべての XC コマーシャル (C) およびインダストリアル (I) グレード FPGA 製品に該当します。

説明

アセンブリサプライヤーは、FG(G) および BG(G) パッケージにおいてコーナーゲートモールドからピンゲートモールドへの移行を進めています。生産性の向上に向けて十分に実績のある PBGA デバイスが PGM へ移行されます。PGM プロセスは、ザイリックスのパッケージ外形寸法の仕様を満たしている、JEDEC 準拠の大きなモールドキャップを考慮して設計されています。

さらに次の変更が適用されます。

1. マーキングテンプレートのマイナー変更 :CGM のイジェクターピンは図 1 のピン 1 が示す位置のまま変わりませんが、PGM のイジェクターピンはパッケージの中央に移動します。PGM および CGM における新しいマーキングテンプレートは、BG(G)256、FG(G)320、FG(G)400、FG(G)456、FG(G)484 および FG(G)676 デバイスパッケージすべてに適用される予定です (図 1 参照)。
2. 出荷トレイ : 23mm x 23mm PBGA パッケージの出荷トレイが変更されます。Daewon 社製の新しい 23mm x 23mm PBGA トレイマトリクスは、現在の出荷トレイと互換性があり、トレイの X/Y 寸が一致します。ただし、この新しい Daewon 社製 23mm x 23mm トレイには滑り止めが付いているため、現在のトレイに積み重ねることはできません。新しいトレイには、セルキャビティの底面に大きなキャビティポケットが設けられています。これは、CGM および PGM (より大きなモールド本体) に合せて設計されています。新しい Daewon 社製トレイと現在の出荷トレイを重ねたり、混ぜて使用したりしないことを推奨します。詳細は、表 2 および図 2 を参照してください。

この変更による、フォーム、形状、機能、信頼性への影響はありません。

該当製品

該当製品には、XC コマーシャル (C) およびインダストリアル (I) グレード デバイスのすべての標準とそれらの SCD (Specification Control Document) 製品が含まれます (表 1 参照)。

表 1 : PGM を採用した該当 FPGA デバイス ファミリ

デバイス	パッケージ	デバイス	パッケージ	デバイス	パッケージ	デバイス	パッケージ
XC95288XL	BG(G)256	XC2S600E *	FG(G)456	XC6SLX150	FG(G)484	XC3S4000	FG(G)676
XC3S1000	FG(G)320	XC2V1000 *	FG(G)456	XC6SLX150T	FG(G)484	XC3S5000	FG(G)676
XC3S1200E	FG(G)320	XC2V250 *	FG(G)456	XC6SLX25	FG(G)484	XC3SD1800A	FG(G)676
XC3S1500	FG(G)320	XC2V500 *	FG(G)456	XC6SLX25T	FG(G)484	XC3SD3400A	FG(G)676
XC3S1600E	FG(G)320	XC2VP2	FG(G)456	XC6SLX45	FG(G)484	XC6SLX100	FG(G)676
XC3S200A	FG(G)320	XC2VP4	FG(G)456	XC6SLX45T	FG(G)484	XC6SLX100T	FG(G)676
XC3S400	FG(G)320	XC2VP7	FG(G)456	XC6SLX75	FG(G)484	XC6SLX150	FG(G)676
XC3S400A	FG(G)320	XC3S1000	FG(G)456	XC6SLX75T	FG(G)484	XC6SLX150T	FG(G)676
XC3S500E	FG(G)320	XC3S1500	FG(G)456	XC2S400E *	FG(G)676	XC6SLX45	FG(G)676
XC3S1200E	FG(G)400	XC3S2000	FG(G)456	XC2S600E *	FG(G)676	XC6SLX75	FG(G)676
XC3S1600E	FG(G)400	XC3S400	FG(G)456	XC2V1500	FG(G)676	XC6SLX75T	FG(G)676
XC3S400A	FG(G)400	XCMECH	FG(G)456	XC2V2000	FG(G)676	XCE0102 *	FG(G)676
XC3S400AN	FG(G)400	XCV200E *	FG(G)456	XC2V3000 *	FG(G)676	XCE0103 *	FG(G)676
XC3S700A	FG(G)400	XCV300E *	FG(G)456	XC2VP20	FG(G)676	XCE0203	FG(G)676
XC2S100E *	FG(G)456	XC3S1400A	FG(G)484	XC2VP30	FG(G)676	XCMECH	FG(G)676
XC2S150	FG(G)456	XC3S1400AN	FG(G)484	XC2VP40	FG(G)676	XCV400E *	FG(G)676
XC2S150E *	FG(G)456	XC3S1600E	FG(G)484	XC3S1000	FG(G)676	XCV405E *	FG(G)676
XC2S200	FG(G)456	XC3S700A	FG(G)484	XC3S1400A	FG(G)676	XCV600E	FG(G)676
XC2S200E	FG(G)456	XC3S700AN	FG(G)484	XC3S1400AN	FG(G)676		
XC2S300E *	FG(G)456	XC6SLX100	FG(G)484	XC3S1500	FG(G)676		
XC2S400E *	FG(G)456	XC6SLX100T	FG(G)484	XC3S2000	FG(G)676		

* [XCN12026](#) PDN に該当するデバイスです。

PGM および CGM の新しいマーキング テンプレートの例を次に示します。



レーザー マークピン 1
CGM のイジェクター ピンと
同じ位置を示す

図 1 : マーキング テンプレート

表 2：トレイ情報

トレイ タイプ	現在のトレイ		新規トレイ	
	Daewon 社のトレイ 製品番号	ザイリンクス 図面番号	Daewon 社のトレイ 製品番号	ザイリンクス 図面番号
23 x 23mm パッケージ用 JEDEC L/P PBGA TRAY (60 ポケット)	1F1-2323-919 Rev. A	SIT0089	T0812012 Rev. B	SIT0148

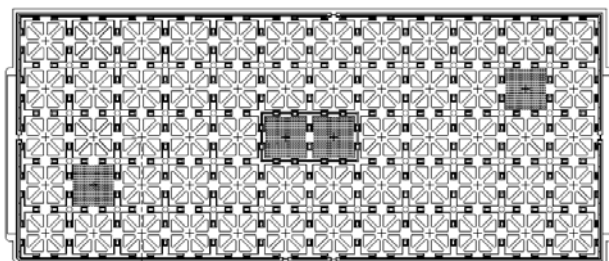
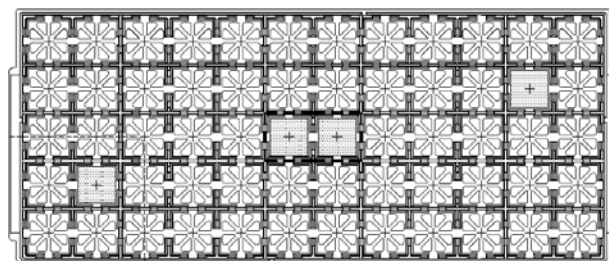

 現在のトレイ：1F1-2323-919 Rev.A
ベンダー：Daewon

 新規トレイ：T0812012 Rev.B
ベンダー：Daewon

図 2：トレイ詳細図

キーデートおよび注文情報

ザイリンクスは、新しいマーキング テンプレートを採用した PGM および CGM パッケージの混合出荷を 2014 年 2 月 1 日までに開始します。

品質評価データ

サプライヤーは既に PGM パッケージの評価を行っており、2009 年から量産に使用されています。さらにザイリンクスによって、[表 3](#) に示すザイリンクス デバイス/パッケージを使用した評価が行われます。品質評価データは、[表 4](#) に記載のスケジュールに従って入手可能となる予定です。

表 3：品質評価プラン

デバイス	パッケージ	信頼性テスト	SS
XC6SLX100T	FGG676	PC3+TCB1000x	25 x 3 lots
XC2VP40	FGG676	PC3+TCB1000x	25 x 3 lots
XC3S5000	FGG676	PC3+TCB1000x	25 x 3 lots

表 4：品質評価スケジュール

パッケージ タイプ	モールド キャビティ タイプ	条件付き品質評価の予定	製品リリースの予定
ワイヤ ボンド FG(G) パッケージ	ピンゲートモールド	2013 年 6 月 30 日	2014 年 2 月 1 日

お問い合わせ

この通知に対する回答は必要ありません。その他ご不明な点、ご質問等ございましたら、[ザイリンクス テクニカル サポート](#)までお問い合わせください。

重要なお知らせ :ザイリンクス カスタマー通知 (XCN、XDN、Quality Alert) リリースの通知は、サポートウェブサイト (<http://japan.xilinx.com/support>) から e-mail で受け取ることができます。アカウントご登録後、資料とデザイン アドバイザリ アラートにカスタマー変更通知が含まれるようにカスタマイズしてください。ザイリンクス サポート サイトでは、指定された製品に関する新規および更新情報、データシートやエラッタ、アプリケーション ノートなどに関するアラートを受け取ることができます。サービスを提供しています。

登録方法は、ザイリンクス アンサー 18683 (<http://japan.xilinx.com/support/answers/18683.htm>) を参照してください。

改訂履歴

次の表に、この文書の改訂履歴を示します。

日付	バージョン	内容
2012 年 12 月 17 日	1.0	初版リリース
2013 年 1 月 25 日	1.0.1	「説明」セクションで、出荷トレイに「PGM」を追加。

Notice of Disclaimer

The information disclosed to you hereunder (the "Materials") is provided solely for the selection and use of Xilinx products. To the maximum extent permitted by applicable law: (1) Materials are made available "AS IS" and with all faults, Xilinx hereby DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE; and (2) Xilinx shall not be liable (whether in contract or tort, including negligence, or under any other theory of liability) for any loss or damage of any kind or nature related to, arising under, or in connection with, the Materials (including your use of the Materials), including for any direct, indirect, special, incidental, or consequential loss or damage (including loss of data, profits, goodwill, or any type of loss or damage suffered as a result of any action brought by a third party) even if such damage or loss was reasonably foreseeable or Xilinx had been advised of the possibility of the same. Xilinx assumes no obligation to correct any errors contained in the Materials, or to advise you of any corrections or update. You may not reproduce, modify, distribute, or publicly display the Materials without prior written consent. Certain products are subject to the terms and conditions of the Limited Warranties which can be viewed at <http://www.xilinx.com/warranty.htm>; IP cores may be subject to warranty and support terms contained in a license issued to you by Xilinx. Xilinx products are not designed or intended to be fail-safe or for use in any application requiring fail-safe performance; you assume sole risk and liability for use of Xilinx products in Critical Applications: <http://www.xilinx.com/warranty.htm#critapps>.

この通知は参照用として、英語版 (XCN12023、バージョン 1.0.1、2013 年 1 月 25 日発行) を翻訳したものです。